

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已于 2024 年 1 月 25 日和 2024 年 2 月 22 日分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据最新情况，于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序、公司经营范围、总股本、因总股本变化导致的本次发行数量上限、股东持股数量、《公司法》适用条款外，其他修订具体情况如下：

一、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景及目的/（一）本次向特定对象发行股票的背景/2、半导体专用设备	更新相关市场数据

	市场需求长期保持增长	
	二、本次向特定对象发行股票的背景及目的/(二)本次向特定对象发行股票的目的/1、提升研发投入水平,进一步缩小与海外同行业巨头研发投入的差距	更新海外同行业公司研发投入数据
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、项目方案概述及必要性、可行性分析/(一)研发和工艺测试平台建设项目/3、项目实施的可行性	更新公司研发人员数量及学历情况
	二、项目方案概述及必要性、可行性分析/(一)研发和工艺测试平台建设项目/4、项目投融资概算和进度安排	更新项目备案和环评情况
	二、项目方案概述及必要性、可行性分析/(二)高端半导体设备迭代研发项目/3、项目实施的可行性	更新相关市场数据、收入、利润、在手订单、专利数量等数据
	二、项目方案概述及必要性、可行性分析/(二)高端半导体设备迭代研发项目/4、项目投融资概算和进度安排	更新项目备案情况
	二、项目方案概述及必要性、可行性分析/(二)高端半导体设备迭代研发项目/5、研发投入情况	更新项目预计取得的成果
	二、项目方案概述及必要性、可行性分析/(三)补充流动资金项目/2、项目实施的必要性	更新收入增长情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明/(一)对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素	更新风险因素中与财务数据等相关的内容
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配情况	更新公司最近三年现金股利分配情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况/(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新研发人员数量及占比、专利数量、客户情况

二、《盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告(修订稿)》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
----	------	------

一、本次向特定对象发行股票的背景	(二)半导体专用设备市场需求长期保持增长	更新相关市场数据
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二)本次发行证券的必要性/1、提升研发投入水平,进一步缩小与海外同行业巨头研发投入的差距	更新海外同行业公司的研发投入数据
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一)本次发行对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	(四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况/2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新研发人员数量及占比、专利数量、客户情况

三、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	(一)研发和工艺测试平台建设项目/3、项目实施的可行性	更新公司研发人员数量及学历情况
	(一)研发和工艺测试平台建设项目/4、项目投融资概算和进度安排	更新项目备案和环评情况
	(二)高端半导体设备迭代研发项目/3、项目实施的可行性	更新相关市场数据、收入、利润、在手订单、专利数量等数据
	(二)高端半导体设备迭代研发项目/4、项目投融资概算和进度安排	更新项目备案情况
	(二)高端半导体设备迭代研发项目/5、研发投入情况	更新项目预计取得的成果
	(三)补充流动资金项目/2、项目实施的必要性	更新收入增长情况

四、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
二、项目方案概述及必要性、可行性分析	(一)研发和工艺测试平台建设项目/3、项目实施的可行性	更新公司研发人员数量及学历情况
	(一)研发和工艺测试平台建设项目/4、项目投融资概算和进度安排	更新项目备案和环评情况

	(二)高端半导体设备迭代研发项目/3、项目实施的可行性	更新相关市场数据、收入、利润、在手订单、专利数量等数据
	(二)高端半导体设备迭代研发项目/4、项目投融资概算和进度安排	更新项目备案情况
	(二)高端半导体设备迭代研发项目/5、研发投入情况	更新项目预计取得的成果
	(三)补充流动资金项目/2、项目实施的必要性	更新收入增长情况

五、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	(一) 测算假设及前提 (二) 对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二) 公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新研发人员数量及占比、专利数量

除上述文件修订外，公司还编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具了鉴证报告。此外，立信会计师事务所（特殊普通合伙）还出具了《2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年10月22日